



# 2023年3月期第2四半期 決算説明

1. 当期連結決算においては、フェローテック単体は2022年4月～2022年9月末の業績を、それ以外の連結子会社・持分法適用会社は2022年1月～6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2023年3月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

# 連結決算サマリー

(百万円)	2022/3期 2Q	2023/3期 2Q	前年同期比	
	金額	金額	金額	増減率(%)
売上高	59,826	97,505	37,679	63.0
売上原価	37,587	62,967	25,380	67.5
売上総利益	22,238	34,538	12,300	55.3
販売管理費	11,530	17,476	5,946	51.6
営業利益	10,708	17,061	6,353	59.3
営業外収益	2,283	7,380	5,097	223.3
営業外費用	523	888	365	69.8
経常利益	12,468	23,554	11,086	88.9
特別利益	9,339	822	△ 8,517	△ 91.2
特別損失	1,162	768	△ 394	△ 33.9
非支配株主に帰属する 四半期純利益	345	1,989	1,644	476.5
親会社株主に帰属する 四半期純利益	17,257	15,979	△ 1,278	△ 7.4
設備投資額	13,898	24,928	11,030	79.4
減価償却費	3,820	5,596	1,776	46.5

売上高975億円、前年同期比+ 63 %  
 営業利益171億円、前年同期比+ 59 %  
 四半期純利益160円、前年同期比△ 7 %

・販売管理費  
 労務費、試験研究費の増加等により、  
 前年同期比+ 52 %

・営業外収益  
 為替差益 5,196百万円

・営業外費用  
 持分投資損失(損益ネット) 249百万円  
 (内、ウエーハ事業3社 545百万円)

特別利益

・持分変動利益 618百万円  
 (无锡海古徳の第三者割当増資 9.5百万円・ 8.45元/株)

・段階取得に係る差益(東洋刃物TOB) 204百万円

特別損失

・段階取得に係る差損(大泉製作所TOB) 702百万円  
 法人税等 5,639百万円、前年同期比+ 2,596百万円  
 非支配株主に帰属する四半期純利益(損益ネット)

・シリコンパーツ・石英坩堝事業 895百万円  
 ・パワー半導体基板事業 876百万円  
 ・洗浄事業 259百万円

注 為替レート2021/3月期 2Q→2022/3月期 2Q : 米ドル 108.45円→124.52円 人民元 16.76円→ 19.13円(期中平均レート)

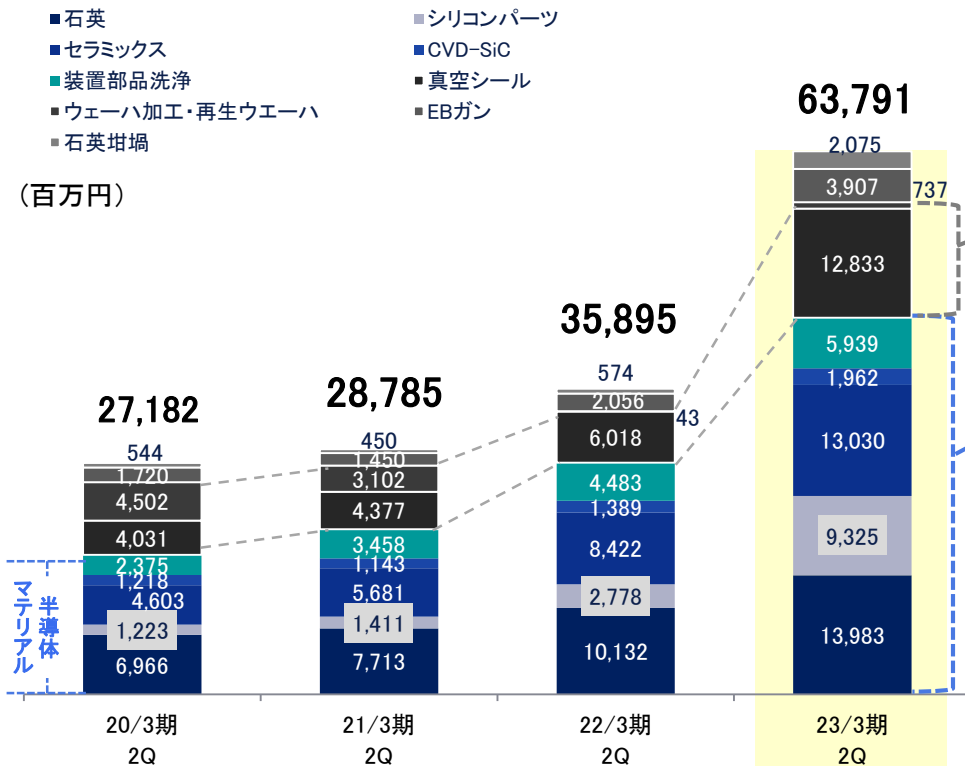
# セグメント別売上高および営業利益

売上高 (単位:百万円)	2022/3期 2Q		2023/3期 2Q		前年同期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	39,178	65.5	63,791	65.4	24,613	62.8
電 子 デ バ イ ス	12,213	20.4	23,073	23.7	10,860	88.9
そ の 他	8,434	14.1	10,640	10.9	2,206	26.2
合 計	59,826	100.0	97,505	100.0	37,679	63.0

営業利益 (単位:百万円)	2022/3期 2Q		2023/3期 2Q		前年同期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	7,118	18.2	11,707	18.4	4,589	64.5
電 子 デ バ イ ス	3,052	25.0	5,325	23.1	2,273	74.5
そ の 他	660	7.8	398	3.7	△ 262	△ 39.7
全 社 消 去	△123	-	△369	-	△ 246	-
合 計	10,708	17.9	17,061	17.5	6,353	59.3

(百万円)	2022/3期 2Q	2023/3期 2Q	前年同期比 (%)
半 導 体 等 装 置 関 連	39,178	63,791	62.8
真空シール・金属加工	8,228	12,833	56.0
石英製品	10,132	13,983	38.0
シリコンパーツ	2,778	9,325	235.7
セラミックス	8,422	13,030	54.7
CVD-SiC	1,389	1,962	41.3
EBガン・LED蒸着装置	3,129	3,907	24.9
ウエーハ加工(連結対象のみ)	43	85	97.7
再生ウエーハ	-	652	-
装置部品洗浄	4,483	5,939	32.5
石英坩堝	574	2,075	261.5
電 子 デ バ イ ス	12,213	23,073	88.9
サーモジュール	8,424	11,546	37.1
パワー半導体基板	3,349	7,919	136.5
磁性流体・その他	440	485	10.2
New → センサ(大泉製作所)	-	3,123	-
そ の 他	8,434	10,640	26.2
合 計	59,826	97,505	63.0

## 売上高の推移



## セグメント総括

- ・金属加工、半導体材料とも能力増強が奏功、増収
- ・真空シール・金属加工は前同比+113%、シリコンパーツは前同比+236%

### 真空シール・金属加工、ウエーハ加工・再生ウエーハ

- ・真空シール・金属加工: 前同比+113%、半導体製造装置メーカーの金属加工需要を積極的に取込み、増強した常山工場等が稼働
- ・ウエーハ加工・再生ウエーハ: 再生ウエーハ銅陵工場が稼働開始

### 半導体材料、洗浄事業

#### 【半導体材料 (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】

- ・石英: 前同比+38%、需要伸長中、常山工場・東台工場が稼働
- ・シリコンパーツ: 前同比+236%、需要増に対応し、銀川工場増強
- ・セラミックス: 前同比+55%、半導体向け需要増、杭州工場増強
- ・CVD-SiC: 前同比+41%、半導体向け需要増、岡山工場増産

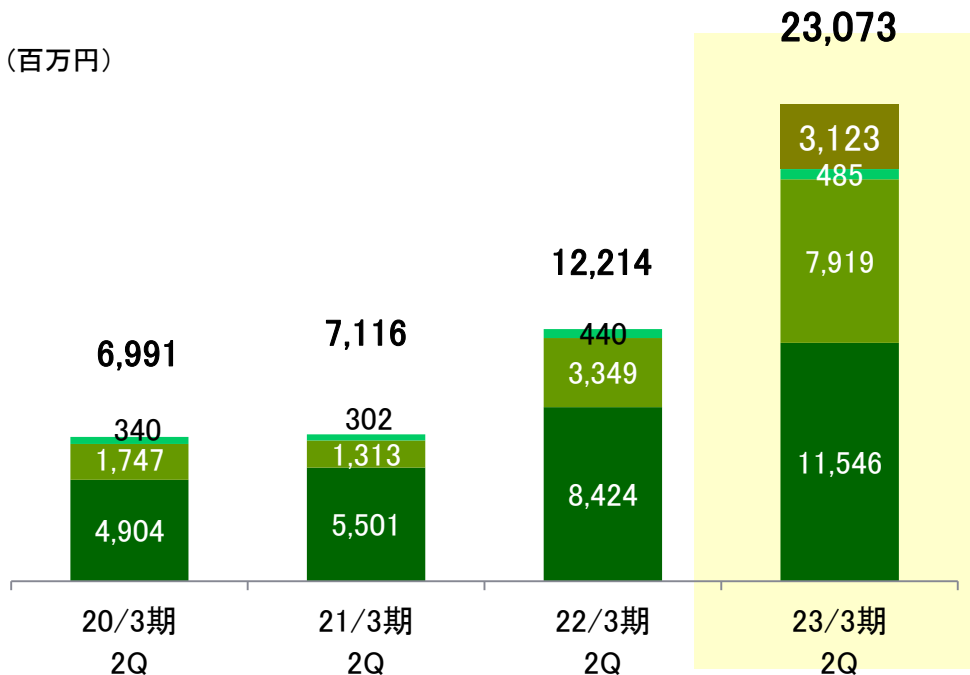
#### 【洗浄事業】

- ・前同比+38%、中国における半導体メーカー・FPDメーカーの洗浄需要増加を取込み

## 売上高の推移

- サーマモジュール
- パワー半導体基板
- 磁性流体、他
- センサ(大泉製作所)

(百万円)



## セグメント総括

- ・パワー半導体基板は、AMB基板の売上急伸等により増収
- ・サーモジュールも、堅調
- 【サーモジュール】
- ・前同比+37%、5G通信機器向けが順調、PCR等バイオ向けも堅調、自動車温調シート向け減をカバー
- 【パワー半導体基板】
- ・前同比+137%、特に、自動車・EV等向けのAMB基板売上が急伸
- ・DCB基板も生産能力の増強が寄与し、売上拡大
- ・研究院の機能強化が奏功し、高耐熱・高強度のDPC基板も展開、更なる製品開発を推進中

# 連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2022/3期 期末	2023/3期 9月末	増減額
流動資産	133,414	190,942	57,528
現金及び預金	52,579	83,825	31,246
受取手形及び売掛金	41,797	58,279	16,482
たな卸資産	28,436	42,557	14,121
固定資産	131,358	179,390	48,032
有形固定資産	84,083	122,616	38,533
建物及び構築物	22,728	30,782	8,054
機械装置及び運搬具	25,122	34,599	9,477
工具、器具及び備品	5,324	6,295	971
土地	1,895	4,160	2,265
リース資産(純額)	4,040	9,269	5,229
建設仮勘定	24,972	37,508	12,536
無形固定資産	1,996	5,852	3,856
のれん	283	3,427	3,144
投資その他資産	45,277	50,921	5,644
資産合計	264,772	370,333	105,561

## 【流動資産の主な増加要因等】

・現預金31,246百万円の内、第三者割当増資を実施した中国子会社\*の現預金残高増加19,759百万円  
\*FTNC(シリコンパーツ・石英坩堝)、FLH(パワー半導体基板)  
受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加は、売上増加による

## 【有形固定資産の主な増加要因等】

・建設仮勘定12,536百万円は、主に中国の銅陵再生ウエーハ事業、上海中国本社、広州洗浄事業、常山真空シール・金属加工事業の子会社における設備投資

## 【投資その他資産の主な増加要因等】

・中国子会社によるSiCパワーデバイスメーカーである蕪湖啓迪半導体有限公司への出資4,076百万円

# 連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	2022/3期 期末	2023/3期 9月末	増減額
流動負債	68,800	95,160	26,360
支払手形及び買掛金	26,702	34,091	7,389
短期借入金	6,324	13,650	7,326
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	8,501	13,279	4,778
固定負債	35,014	50,145	15,131
社債	8,806	5,082	△ 3,724
転換社債型新株予約権付社債	2,134	—	△ 2,134
長期借入金	11,796	24,647	12,851
負債合計	103,814	145,306	41,492
純資産	160,957	225,026	64,069
株主資本	117,511	144,623	27,112
その他の包括利益累計額	13,511	30,708	17,197
非支配株主持分	29,888	49,651	19,763
負債・純資産合計	264,772	370,333	105,561
自己資本比率	49.5%	47.3%	-2.2pt

## 【流動負債、固定負債の主な変動要因等】( )内は2022/3期末比

短期借入+1年内長借・社債	26,929百万円 (+12,102)
長期借入+社債・転換社債	29,729百万円 (+ 6,992)
有利子負債 合計	56,658百万円 (+19,094)

## 【純資産の主な変動要因等】( )内は2022/3末比

- ・資本剰余金 57,105百万円(+11,034)  
主に中国子会社の第三者割当増資による
- ・利益剰余金 58,276百万円(+14,959)
- ・為替換算調整勘定 30,462百万円(+17,334)  
円安進行に伴い増加
- ・非支配株主持分  
中国のFLH(パワー半導体基板)、FTNC(シリコンパーツ・石英  
坩堝への第三者割当増資による増加、大泉製作所(センサ)の  
連結子会社化による増加

## 【自己資本比率】

自己資本比率は47.3%と、中計の目標値40%を超過

注 為替レート2022/3月期末→2022/3月期9月末：米ドル 115.02円→136.68円 人民元 18.06円→ 20.38円(期末レート)



# キャッシュフロー計算書

(百万円)	2022/3期 2Q	2023/3期 2Q
<b>営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>6,369</b>	<b>20,988</b>
税金等調整前四半期純利益	20,645	23,608
減価償却費	3,820	5,596
為替差損益(△:益)	△ 1,199	△ 2,000
売上債権の増減(△:増加)	△ 2,737	△ 3,288
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 3,523	△ 5,091
仕入債務の増減(△:減少)	1,800	△ 2,271
持分変動損益(△:益)	△ 9,327	△ 618
その他	△ 3,110	5,052
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>△ 8,226</b>	<b>△ 28,783</b>
有形固定資産取得による支出	△ 13,814	△ 24,852
有形固定資産の売却による収入	351	168
無形固定資産の取得による支出	△ 84	△ 76
その他	5,321	△ 4,023
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>18,274</b>	<b>32,461</b>
短期借入金の増減額	114	4,170
長期借入れによる収入	1,707	14,366
長期借入金の返済による支出	△ 3,666	△ 3,717
社債の償還による支出	△ 1,434	△ 1,434
非支配株主からの払込みによる収入	22,181	20,515
その他	△ 628	△ 1,439
<b>現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>18,007</b>	<b>31,192</b>
現金及び現金同等物の期首残高	30,202	52,579
現金及び現金同等物の期末残高	48,210	83,770

## 【営業CFの状況】

税金等調整前四半期純利益+減価償却費: 29,204百万円

売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減: △10,650百万円

## 【投資CFの状況】

有形・無形固定資産の取得: △24,928百万円

## 【財務CFの状況】

非支配株主からの払込みによる収入: 20,515百万円

・FTNC(シリコンパーツ・石英坩堝) 10,644百万円

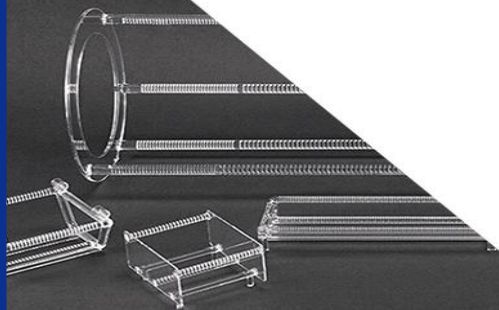
・FLH(パワー半導体基板) 9,630百万円



**FerroTec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## 2023年3月期の業績予想について



- 8月12日に上方修正した業績予想、11月14日に、再度上方修正
- 為替相場における円安傾向等を反映したもの(想定為替レートは、1米ドル 125 円→ 133 円に修正)

	2022/3期	2023/3期(計)		
(百万円)	実績	8/12修正時	11/14修正予想	前期比(%)
売上高	133,821	195,000	200,000	49.5
営業利益	22,600	32,500	34,000	50.4
経常利益	25,994	34,000	39,000	50.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	26,659	20,000	24,000	△ 10.0
減価償却費	8,085	13,297	13,081	△ 1.6
EBITDA	30,685	45,797	47,081	2.8
想定為替レート(期中平均)	米ドル: 110.37円 人民元: 17.12円	米ドル: 124.52円 人民元: 19.13円	米ドル: 132.80円 人民元: 19.50円	-

\*EBITDA=営業利益+減価償却費にて計算、連結子会社の外部出資に相当する損益は、非支配者株主損益に織込み

Copyright © Ferrotec Holdings Corporation. All Rights Reserved.

# 23/3期 セグメント・製品別の業績予想



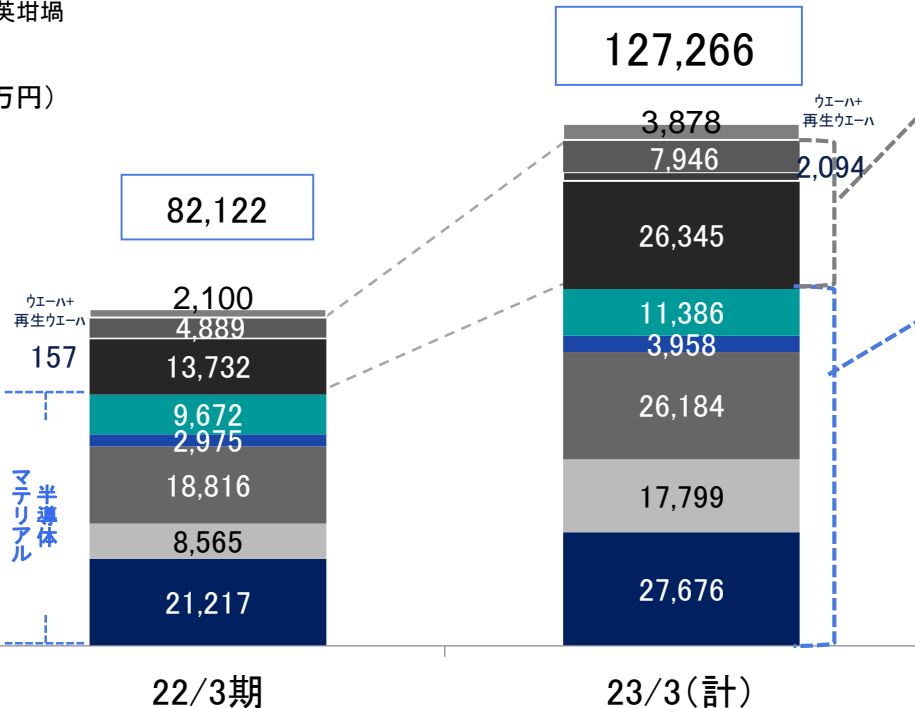
(百万円)	22/3期	23/3期(11/14修正後計画)	YoY(増減率)
半 導 体 等 装 置 関 連	82,122	127,266	55.0
真空シール・金属加工	13,732	26,345	91.9
石英製品	21,217	27,676	30.4
シリコンパーツ	8,565	17,799	107.8
セラミックス	18,816	26,184	39.2
CVD-SiC	2,975	3,958	33.0
EBガン・LED蒸着装置	4,889	7,946	62.5
ウエーハ加工(連結対象外)	59	206	249.2
再生ウエーハ	98	1,888	-
装置部品洗浄	9,672	11,386	17.7
石英坩堝	2100	3,878	84.7
電 子 デ バ イ ス	27,023	53,061	96.4
サーモジュール	17,635	21,390	21.3
パワー半導体	8,473	20,849	146.1
磁性流体・その他	916	933	1.9
センサ(大泉製作所)	-	9,888	-
そ の 他	24,674	19,673	△ 20.3
合 計	133,821	200,000	49.5

## 売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工+再生ウェーハ
- 石英坩堝

- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン

(百万円)



## セグメント総括

- ・金属加工、半導体材料とも能力増強が奏功、増収
- ・真空シール・金属加工は前期比+92%、シリコンパーツは前期比+108%

### 真空シール・金属加工

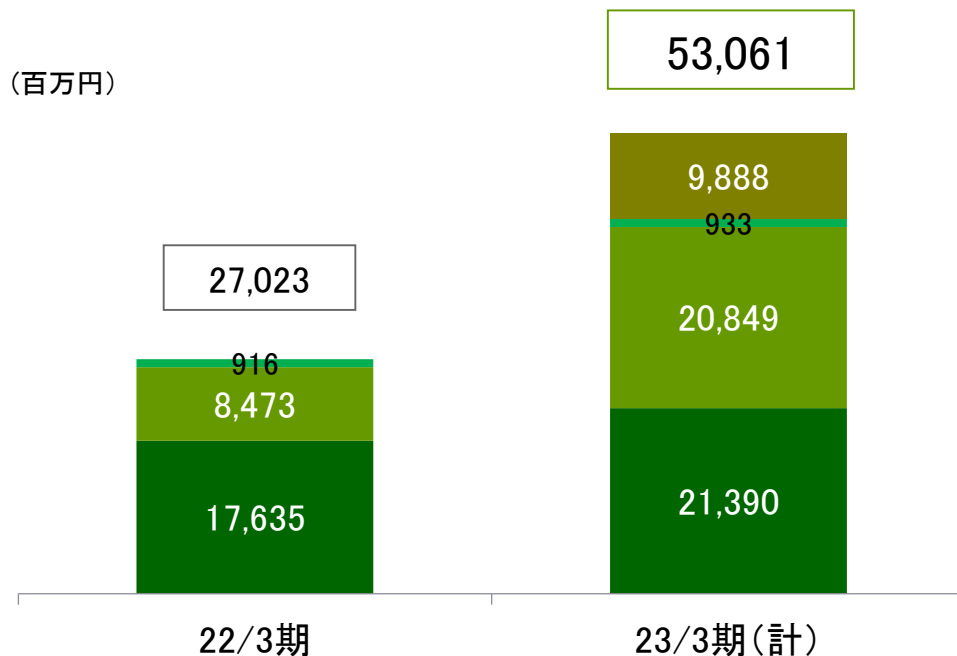
- ・真空シール・金属加工: 前期比+92%、半導体製造装置メーカーの金属加工需要取込み、常山工場等が稼働
- ・ウエーハ加工・再生ウエーハ: 再生ウエーハ銅陵工場が稼働

### 半導体材料、洗浄事業

- 【半導体材料 (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】
- ・石英: 前期比+30%、需要は底堅い見通し
  - ・シリコンパーツ: 前同比+108%、需要増、銀川工場増強が奏功
  - ・セラミックス: 前同比+39%、半導体向け需要堅調、杭州工場稼働
  - ・CVD-SiC: 前同比+33%、半導体向け需要増、岡山工場増産
- 【洗浄事業】
- ・前同比+18%、中国における洗浄需要は堅調

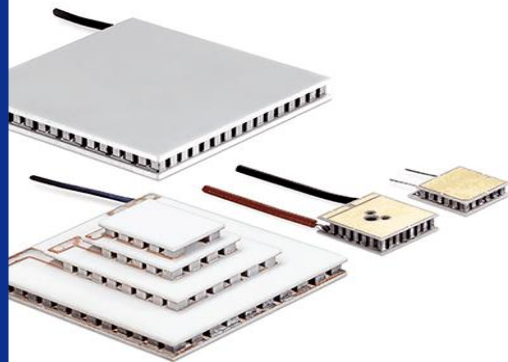
## 売上高の推移

■ サーモモジュール ■ パワー半導体基板 ■ 磁性流体・その他 ■ センサ(大泉製作所)

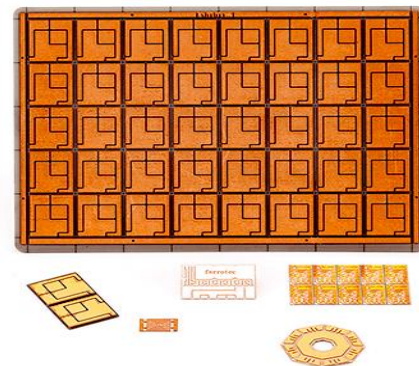


## セグメント総括

- ・パワー半導体基板は、AMB基板の売上増加が継続
  - ・サーモモジュールも、堅調推移
- 【サーモモジュール】
- ・前同比+21%、5G通信機器向け、バイオ向けとも堅調
- 【パワー半導体基板】
- ・前同比+146%、自動車・EV等向けのAMB基板が需要増加するなか、能力拡大が奏功し、売上が続伸
  - ・DCB基板も好調継続
  - ・DPC基板等の製品レンジ拡大も推進中



**FerroTec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## 財務運営について



- ・ 半導体マテリアル、パワー半導体基板等増産に加え、東洋刃物・大泉製作所投資を実行
- ・ 期初策定した3カ年の投資計画1,800億円(M&Aによる株式取得含む)は、現状不変

## 【期初の投資計画】

計 **1,800** 億円



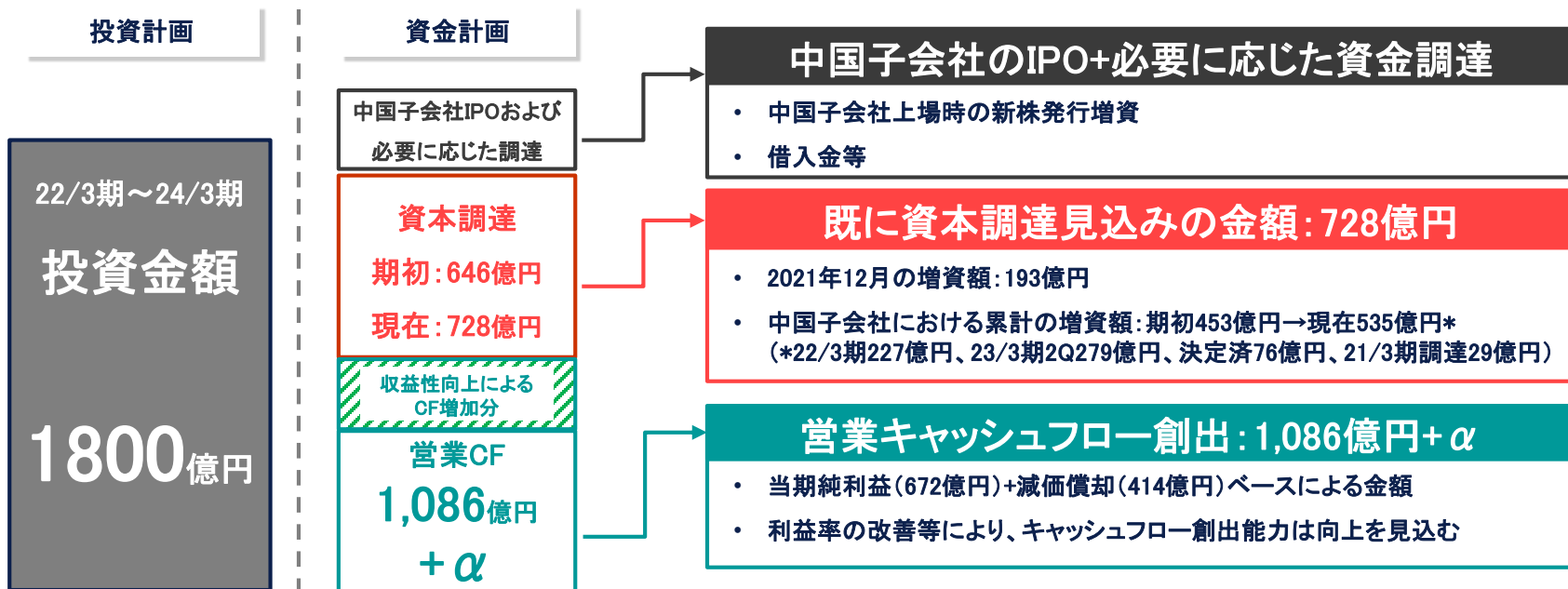
中計3か年での投資計画

## 【現在までの進捗】

- ・ 22/3期354億円、23/3期2Q迄298億円 (株式取得含む)
- ・ マテリアル製品(石英、セラミックス、シリコンパーツ)、パワー半導体基板等の増産投資を実施
- ・ マレーシア投資、石川新工場設立、熊本工場新設に着手
- ・ 東洋刃物の100%子会社化、大泉製作所の51%出資・連結化を実施
- ・ 現状、期初に策定した投資計画1,800億円にて不変、今後 新たなM&A案件や連結化した子会社の投資計画等により見直しの可能性はあり



- 3カ年の資本調達予定金額と営業CF(当期純利益+減価償却)想定金額の合計は、1,800億円超
- 運転資金の増加に対応した資金調達は必要となるが、中国子会社のIPOを見込まず、全額を金融機関借入にて調達した場合でも、自己資本比率40%、D/Eレシオ<sup>注)</sup>0.5倍程度の財務水準を維持する見通しは、期初から不変



【2022年5月30日開示内容】

## 配当政策

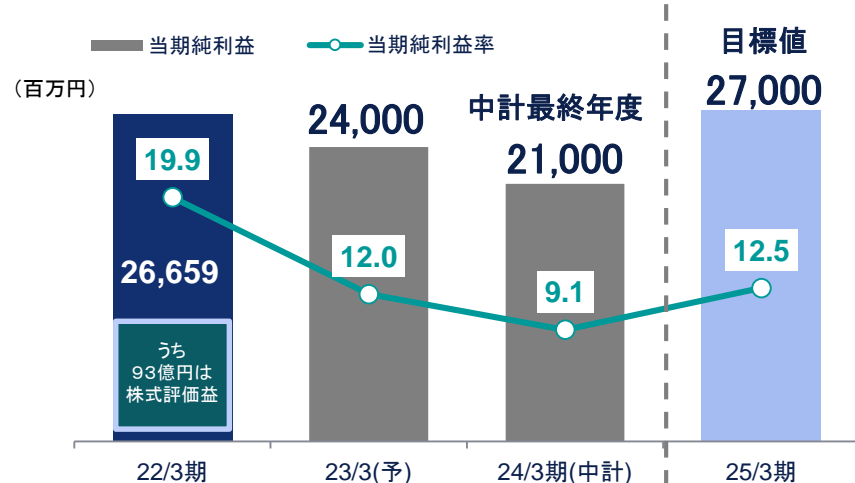
持続的な収益増強により株主還元を増加させていく基本方針は不変だが、配当の決定に際して、「配当性向20%」を意識して、財務・投資機会等とのバランスを考慮して判断する

・1株配当：70円/年 ⇒ 100円/年

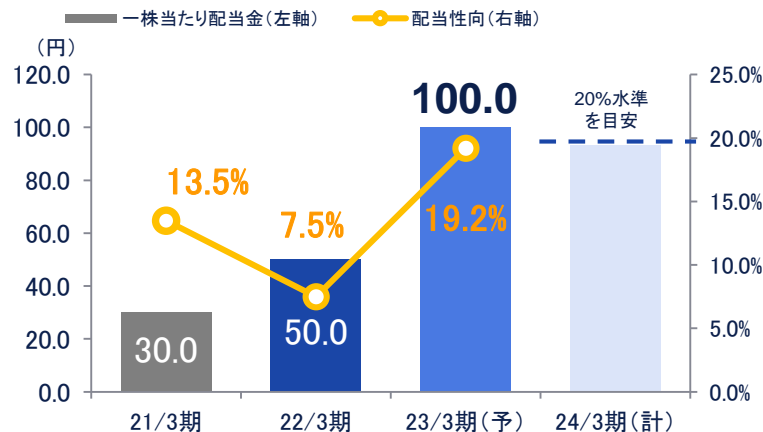
【配当総額】 ( 32億円) ⇒ ( 46億円)  
 【純利益】 (170億円) ⇒ (240億円)

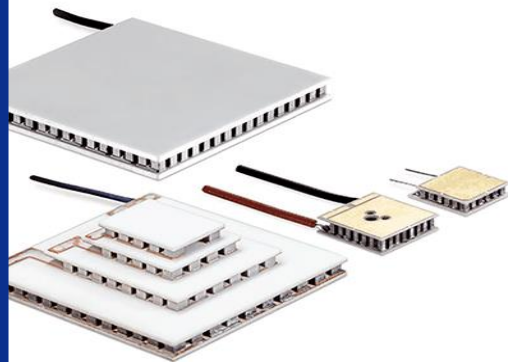
※配当の決定に際しては、キャッシュインを伴わない一時的な利益(持分変動利益など)を控除した後の当期純利益水準も考慮して判断致します。

### 当期純利益の目標値

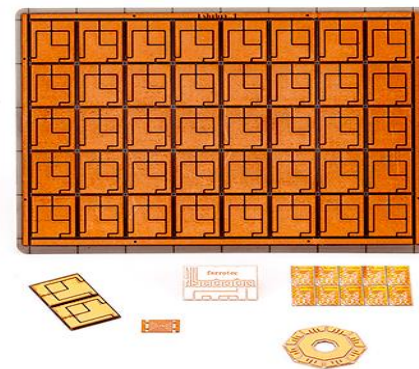


### 配当金の目標値





**Ferrotec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## Appendix



# 業績比較(23/3期 上期 計画値と実績)

(百万円)	2023/3期2Q 計画値		2023/3期2Q 実績				
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)	
半 導 体 等 装 置 関 連	59,029	65.6	63,791	65.4	4,763	8.1	
真空シール・金属加工	11,595	12.9	12,833	13.2	1,238	10.7	
石英製品	12,617	14.0	13,983	14.3	1,366	10.8	
シリコンパーツ	9,138	10.2	9,325	9.6	187	2.0	
セラミックス	12,301	13.7	13,030	13.4	730	5.9	
CVD-SiC	1,846	2.1	1,962	2.0	116	6.3	
EBガン・LED蒸着装置	3,144	3.5	3,907	4.0	763	24.3	
ウエーハ加工(連結対象外)	80	0.1	85	0.1	5	6.3	
再生ウエーハ	543	0.6	652	0.7	109	20.1	
部品洗浄	5,720	6.4	5,939	6.1	219	3.8	
石英坩堝	2,045	2.3	2,075	2.1	30	1.5	
電 子 デ バ イ ス	20,303	22.6	23,073	23.7	2,770	13.6	
サーモモジュール	9,978	11.1	11,546	11.8	1,568	15.7	
パワー半導体	6,650	7.4	7,919	8.1	1,269	19.1	
磁性流体・その他	479	0.5	485	0.5	6	1.3	
センサ(大泉製作所)	3,196	3.6	3,123	3.2	△ 73	△ 2.3	
そ の 他	10,667	11.9	10,640	10.9	△ 27	△ 0.2	
合 計 ( 連 結 売 上 高 )	90,000	100.0	97,505	100.0	7,505	8.3	
売 上 総 利 益	32,528	36.1	34,538	35.4	2,010	6.2	
販 売 管 理 費	16,528	18.4	17,476	17.9	948	5.7	
営 業 利 益	15,999	17.8	17,061	17.5	1,062	6.6	
経 常 利 益	19,000	21.1	23,554	24.2	4,554	24.0	
四 半 期 純 利 益	12,000	13.3	15,979	16.4	3,979	33.2	

※以降、当期・四半期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益を指す  
数値については一部丸め処理を行ったものを記載

# 業績比較(23/3期 上期実績と下期計画値)

(百万円)	2023/3期2Q 実績		2023/3期2Q 下期計画値				
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)	
半 導 体 等 装 置 関 連	63,791	65.4	63,475	61.9	△ 317	△ 0.5	
真空シール・金属加工	12,833	13.2	13,512	13.2	678	5.3	
石英製品	13,983	14.3	13,693	13.4	△ 290	△ 2.1	
シリコンパーツ	9,325	9.6	8,474	8.3	△ 851	△ 9.1	
セラミックス	13,030	13.4	13,154	12.8	123	0.9	
CVD-SiC	1,962	2.0	1,996	1.9	34	1.7	
EBガン・LED蒸着装置	3,907	4.0	4,039	3.9	132	3.4	
ウエーハ加工(連結対象外)	85	0.1	121	0.1	36	42.4	
再生ウエーハ	652	0.7	1,236	1.2	584	89.6	
部品洗浄	5,939	6.1	5,447	5.3	△ 492	△ 8.3	
石英坩堝	2,075	2.1	1,803	1.8	△ 272	△ 13.1	
電 子 デ バ イ ス	23,073	23.7	29,988	29.3	6,915	30.0	
サーモモジュール	11,546	11.8	9,845	9.6	△ 1,701	△ 14.7	
パワー半導体	7,919	8.1	12,930	12.6	5,011	63.3	
磁性流体・その他	485	0.5	448	0.4	△ 37	△ 7.6	
センサ(大泉製作所)	3,123	3.2	6,765	6.6	3,642	116.6	
そ の 他	10,640	10.9	9,033	8.8	△ 1,608	△ 15.1	
合 計 ( 連 結 売 上 高 )	97,505	100.0	102,495	100.0	4,990	5.1	
売 上 総 利 益	34,538	35.4	34,414	33.6	△ 124	△ 0.4	
販 売 管 理 費	17,476	17.9	17,476	17.1	0	0.0	
営 業 利 益	17,061	17.5	16,939	16.5	△ 123	△ 0.7	
経 常 利 益	23,554	24.2	15,446	15.1	△ 8,108	△ 34.4	
四 半 期 純 利 益	15,979	16.4	8,021	7.8	△ 7,958	△ 49.8	

※以降、当期・四半期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益を指す  
数値については一部丸め処理を行ったものを記載

- 本資料に掲載されている業績見通しの数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、新型コロナウイルス、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の2023年3月期の設備投資額は、あくまで今期の予算をベースに策定したものであり、確定したものではありません。また、当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<照会先>

IR室 03-3281-8186